

코스피	코스닥
6755.75 (+65.13)	764.86 (+16.64)
금리 (국고채 3년)	환율 (원·달러)
3.865 (-0.094)	1469.40 (+2.80)

LG이노텍
카메라·AI기판 호조
영업익 2057% 경증
03



李 대통령, C-390 수송기 시찰

이재명 대통령과 김혜경 여사가 26일(현지 시간) 브라질 브라질리아 공군기지에 도착해 C-390 수송기 관련 브라질 현지에서 교육받고 있는 우리 공군 조종사 및 정비사들과 기념촬영을 하고 있다. /뉴시스

새 주인 찾는 보험사… 내달 M&A 4건 ‘분수령’

인수가격 넘어 추가자본 등 관심
신한 “롯데손보 외에도 검토중”
2700억 신종자본증권 발행 결정
KDB생명, 내달 7일 본입찰 가능성
삼성·한화 등 5곳 예비입찰 참여

국내 보험업계 인수·합병(M&A) 시장이 오는 8월 중대 분수령을 맞을 전망이다. 그 동안의 탐색전이 실제 협상과 본입찰, 우선 협상대상자 선정 등을 앞두고 있어서다. 롯데손해보험, KDB생명, 에별손해보험, BNP파리바카디프생명 등 4곳의 주

인에 관심이 쏠린다. M&A 성패는 인수 가격 뿐만 아니라 인수 후 추가 자본 투입, 매도자 지원 조건과 금융당국 승인에 달렸다는 평가다. 27일 금융권에 따르면 롯데손보와 KDB생명, 에별손해보험, BNP파리바카디프생명 매각이 각각 가격 협상과 본입찰, 주식매매계약(SPA), 제재 결과라는 관문을 앞두고 있다. 오는 8월 전후로 거래의 윤곽이 예상된다. ◆ 신한-롯데손보, 가격보다 ‘자본효율’ 장정훈 신한금융 최고재무책임자(CFO)는 지난 23일 실적발표 콘퍼런스콜에서 “현

재 롯데손보 외에도 다양한 매물을 검토하고 있으나 확정된 바는 없다”고 밝혔다. 신한금융이 롯데손보를 직접 거론하고 인수 검토를 확인한 것은 이번이 처음이다. 다만 신한금융은 안정적인 보통주자본(CET1)비율 안에서 거래를 추진하겠다는 원칙을 분명히 했다. CET1비율 13.0~13.4%를 관리 구간으로 두고 이를 웃도는 자본만 M&A에 활용하는 한편 투자 수익률(ROI)과 주당순이익(EPS), 주주 환원에 미치는 영향까지 따지겠다는 것. 시장에서는 롯데손보 최대주주인 JKL 파트너스가 매각 희망가격을 약 1조원으로

로 낮췄지만 신한금융과의 가격 차이가 여전히 큰 것으로 보고 있다. 양측이 8월까지 접점을 찾지 못하면 JKL이 9월까지 공개매각에 들어갈 가능성도 거론된다. 신한금융은 같은 날 2700억원 규모의 신종자본증권 발행도 결정했다. 주요 예측 결과에 따라 최대 4000억원까지 늘릴 수 있다. 공식 목적은 자본비용 제고와 운영자금 조달이다. 업계에서는 롯데손보 인수자금과의 직접적인 연관성이 있다는 평가다. <2면에 계속> /김주형 기자 gh471@metroseoul.co.kr



LG 액체냉각, 엔비디아 인증 삼성전자, HBM5 동작속도 50% 향상

600kW급 ‘냉각수 분배 장치’
글로벌 AI 데이터센터 시장 공략

LG전자가 국내 기업 최초로 엔비디아의 액체냉각 장비 품질 인증을 획득하며 글로벌 AI 데이터센터 시장 공략에 나섰다. AI 서버의 발열이 급증하면서 액체냉각 기술이 핵심 인프라로 부상하는 가운데, 이번 인증을 계기로 글로벌 빅테크 고객사 확보와 공급망 확대에 속도를 낼 전망이다. LG전자는 최근 엔비디아로부터 600kW급(킬로와트)급 ‘냉각수 분배 장치(CDU)’에 대한 최종 품질 인증을 획득했다고 27일 밝혔다. 이번에 인증 받은 LG전자 600kW급 CDU는 액체냉각의 심장 역할을 하는 핵심 설비다. 최근 AI 데이터센터에서 활용되는 고대역폭 메모리(HBM)와 고성능 GPU 등 최첨단 반도체의 성능이 높아지면서, AI 서버 랙(Rack)의 전력밀도와 발열량도 빠르게 증가하고 있다. 이 때문에 데이터센터 공간 전체를 식히는 기존

의 공랭식(Air Cooling) 냉각 방식에 칩셋의 열을 직접 흡수하는 액체냉각 솔루션을 추가로 결합하는 방식의 중요성이 커지고 있다. LG전자의 CDU는 고밀도 AI 서버의 GPU와 CPU에 장착된 쿨드 플레이트로 냉각수를 순환시켜, 칩에서 발생하는 열을 회수하는 ‘다이렉트 투 칩(DTC)’ 솔루션을 구현해 기존 공랭식 시스템과 시너지를 발휘한다. 온도 제어 정밀도를 ±0.25℃까지 구현해 고발열 AI GPU의 열 안정성을 극대화했다. 가상 센서(Virtual Sensor) 기술과 누수 감지 기능을 지원하며, 표준 프로토콜을 통해 데이터센터 통합관리시스템과 유기적으로 연동된다. 엔비디아가 요구한 장애 대비 운전 시험에서도 펌프나 CDU 그룹에 이상이 생겼을 때 예비 장치로 안정적으로 전환돼, 냉각 운전이 중단 없이 유지될 수 있음을 확인했다. <2면에 계속> /차현정 기자 hyeon@metro



GAA 기반 2나노 공정 적용

삼성전자가 8세대 고대역폭메모리(HBM5)에 게이트올라라운드(GAA) 기반 2나노 공정을 적용하며 인공지능(AI) 메모리 경쟁력 강화에 나선다. HBM의 핵심 구성 요소인 베이스 다이에 최첨단 파운드리 공정을 도입해 성능과 전력 효율을 끌어올리고, 메모리부터 파운드리, 패키징까지 아우르는 탄력 경쟁력을 앞세워 AI 반도체 시장 공략에 속도를 낸다는 전략이다. 27일 삼성전자 반도체 뉴스룸에 따르면 구자홍 삼성전자 파운드리사업부 기술개발실장(부사장)은 인터뷰를 통해 “HBM5는 직전 세대인 HBM4E보다도 동작 속도를 약 50% 이상 향상해야 할 것으로 예상된다”며 “베이스 다이에 동작 속도는 물론 전력 효율 관점에서도 큰 폭의 개선을 이끌어낼 수 있는 최첨단 공정을 준비하고 있다”고 밝혔다. 이어 “업계 요구에 대응하기 위해 HBM5의 베이스 다이는 GAA 구조를 사용하는 2나노 공정을 적용하고 더욱 높은 집적도의 TSV를 구

현할 예정”이라고 말했다.

삼성전자는 올해 세계 최초로 HBM4를 양산한 데 이어 HBM4E 12단 샘플도 출하했다. HBM4 베이스 다이에 파운드리 4나노 4세대 공정이 적용됐으며, 차세대 HBM5에서는 이를 2나노 공정으로 고도화한다는 구상이다. 구 부사장은 삼성전자가 메모리와 파운드리, 패키징을 모두 수행하는 종합반도체 기업이라는 점도 경쟁력으로 꼽았다. 그는 “HBM은 코어 다리와 베이스 다이를 쌓아 패키징하는 제품”이라며 “삼성전자 HBM은 코어 다이는 메모리에서, 베이스 다이는 파운드리에서 각각 제조한 후 TSP에서 패키징하여 완제품을 만드는 턴키(Turn-key) 솔루션 제품”이라고 설명했다. 이어 “설계 단계에서부터 메모리·파운드리·TSP 조직들이 협업하여 속도, 전력, 발열 및 수율에 유리하게 설계를 최적화할 수 있고 양산 제품을 완성하는 시간을 단축할 수 있다”고 강조했다. /차현정 기자



메트로 한줄뉴스



▲ 김용범 정책실장 “보유세 강화면 다주택자 퇴로 검토” /사진 뉴시스
▲尹 공직선거법 위반 1심 징역형 집유…확정시 국힘 397억 반환

▲정성호 사의표명설에 “검찰개혁 95% 달성… 새 술은 새 부대에”
▲행안부, 폭염 위기경보 ‘심각’ 격상…중대본 가동

▲“장윤기 사형 내려달라”…유가족들, 눈물의 호소
▲고위험 폭음 남성 줄었는데 30대 이상 여성은 늘었다